晶圓製造商

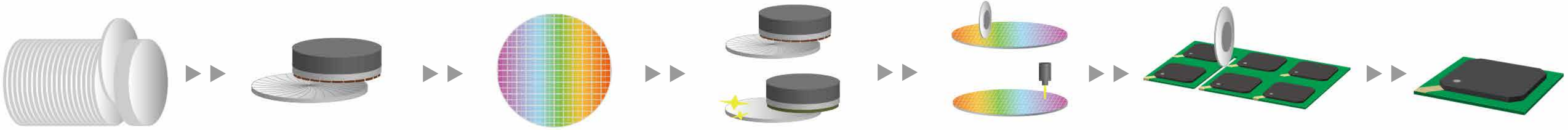
半導體製造商

晶圓製造製程 製造作為半導體基板材料的矽晶圓。

前段製程 在基板晶圓上形成電路，製作半導體晶片。

後段製程 組裝半導體晶片，包括分割、配線和樹脂封裝等。

完成



POINT 1 研削

從矽的晶錠中切出的晶圓，其外周加工會使用迪思科的研削設備（研削機）。經過外形修整及薄化加工，以實現更薄、更高的平坦度。



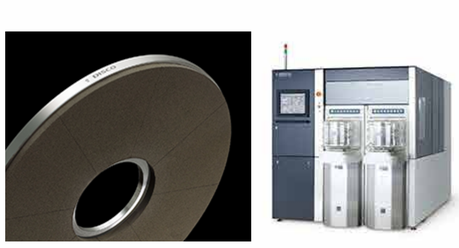
POINT 2 研削

為使表面已形成電路的晶圓變薄，對其背面進行研削（背面研削）。智慧型手機和PC等產品的薄型化，離不開這道製程。



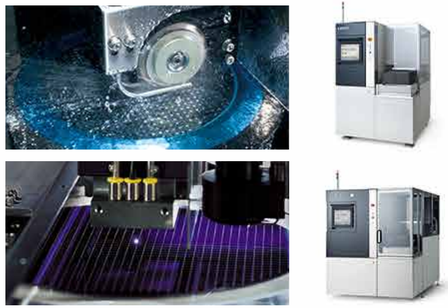
POINT 3 拋光

為提高薄化晶圓的強度，有時會透過拋光去除受損層。本製程使用迪思科的拋光設備（拋光機）。



POINT 4 切割

從薄化後的晶圓切出半導體晶片（切割）。除傳統刀片方式外，近年來雷射切割技術也日益普及。



POINT 5 切割

在樹脂封裝後的封裝體切斷製程中，也會使用迪思科的設備。

